

# 半导体展-2024年深圳举办-深圳半导体展

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 半导体展-2024年深圳举办-深圳半导体展 |
| 公司名称 | FCE展览                 |
| 价格   | .00/件                 |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 中国                    |
| 联系电话 | 15989233176           |

## 产品详情

2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)

半导体产业技术专区

时间：2024年11月13-17日

地点：深圳会展中心(福田)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

创新驱动发展 智慧赋能未来

主办单位

商务部

科学技术部

工业和信息化部

国家发展改革委

农业农村部

国家知识产权局

中国科学院

中国工程院

深圳市人民政府

联合承办单位

中国机电产品进出口商会

科技部机关服务中心

工业和信息化部国际经济技术合作中心

全国农业科技成果转化服务中心

中国专利保护协会

中科院广州分院

中科院深圳先进技术研究院

国家信息中心

亚洲数据集团

中招国际会展(北京)有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

## 展会介绍

随着智能手机、人工智能、AIoT、智能汽车等新技术的快速发展，物联网应用逐渐规模化落地，安防由高清化向智能化的演进，新能源乘用车等众多行业的兴起，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对5G、AI、IoT和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，依然为全球大，69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

作为中国科技创新中心，深圳是我国半导体产品的集散中心、应用中心和设计中心，深圳的半导体产业多年来一直保持高速增长态势，特别是IC设计产业一直位于全国前列。近年来，国内对半导体产业重视力度空前，深圳正作为广东省主阵地打造全国半导体产业第三极，不断加大对半导体产业的政策与资金支持力度。2022年6月，深圳出台“20+8”产业政策，发布了《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，提出加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链条，推动开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和先进制造等相关重点工程，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，高水平打造一批半导体与集成电路产业基地和产业园区。随着政策的发布与实施，在国内5G通信、新能源汽车、工业互联网、大数据、光伏等行业快速发展的大趋势下，以及“碳达峰、碳中和”绿色低碳战略不断推进，第三代半导体市场应用已逐步开启，产业规模不断壮大。

为促进半导体行业新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，推动半导体产业升级，202

4高交会半导体产业技术专区展将于2024年11月13-17日在深圳会展中心盛大举办，展会隶属于第二十六届中国国际高新技术成果交易会专区之一，专注于整合半导体行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为半导体企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的半导体产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外半导体行业创造提升品牌名度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，把握行业发展方向。共享国际化大平台，共拓半导体大市场，让我们携手同行，共创商机。

高交会集成果交易、产品展示、高层论坛、项目招商、合作交流于一体。经过多年发展，高交会已成为中国高新技术领域对外开放的重要窗口，有“中国科技第1展”之称，是中国乃至全世界颇具影响力的品牌展会。高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用。半导体产业技术专区作为高交会的重要组成部分，发挥高交会在国际科技交流合作和科技成果产业化等方面的积极作用，为全球半导体产业提供高品质、国际化、综合性的展览体验平台。将更深度探寻半导体产业低碳转型实施路径，更聚焦打造优化产业链供应链布局的交流合作，更直观展现半导体产业智能科技与时尚元素交融带来的感官冲击，更着力构建以科技创新和融合创新为核心驱动的半导体产业生态圈，引入人工智能、元宇宙等前沿科技理念，描绘未来半导体产业给人们生活带来的无限可能。

### 高交会优势

高交会是目前中国规模颇大、较具影响力的科技类展会，是具有一定国际影响力的品牌展会。

高交会拥有中国政府的强大支持，由多个国家部委院和深圳市人民政府共同举办，多位国家的领导人先后莅临高交会参观指导。首届高交会由时任总理ZRJ宣布开幕，第十届高交会期间，时任国务院WJB专门为高交会题词。

高交会为众多企业带来良好收益，数百家跨国公司先后多次参展，一大批中国民营企业从这里走向世界。

高交会是海内外媒体关注的焦点。每届展会有近200家海内外媒体的约1500多名记者参与报道。不仅包括中国媒体，也有来自海外的主流平面媒体及众多网络媒体。

高交会有强大的推广手段。承办单位专门制订的专项推广计划，新闻发布会、信函直邮和邮件直邮；充分利用多年来与海内外媒体形成的长期合作关系，让海内外企业和客户全面了解高交会。

高交会有优质的观众群体。一直受到海内外人士的热捧，每年的参观人数超过50万人次。

### 机遇和收获

高交会吸引了众多有技术需求的中外企业、中介机构和数千家投资商，将为专利、技术持有者寻找到来自世界各地的合作伙伴。

高交会每年拥有一万多个高新技术项目参展，将为投资商寻找到新的专利、技术、项目以及大量的投资合作机会。

高交会将为全球高新技术产品和服务生产商寻找到产品快速进入中国市场的渠道。

高交会汇聚了各类创新创业资源，通过卓有成效的项目路演、资本对接、技术交流、经验分享等活动，将为各类创业者提供展示、分享、交流的平台。

高交会上各种机构举办的高端发布会和各种论坛会议、酒会等活动，将为所有参会者提供各种资讯，各种商机。

## 展品范围

IC设计：IC及相关电子产品设计、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装、EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计、IDM、Fabless厂等；

芯片：人工智能芯片及方案、电源管理芯片、物联网芯片、5G通信芯片及方案、汽车电子芯片、安全控制芯片、数模混合通讯射频芯片、存储芯片、LED照明及显示驱动类芯片等；

晶圆制造及封装：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板及设备以及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备等；

集成电路制造：晶圆制造厂、晶圆代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数、模混合集成电路制造、集成电路终端产品等；

半导体设备制造：封装设备、扩散设备、焊接设备、清洗设备、测试设备、制冷设备、氧化设备、减薄机、划片机、贴片机、单晶炉、氧化炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、抛光机、倒角机、离子注入设备、CVD/PVD设备、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片沉积系统、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、塑封机、回流焊、波峰焊、测试机、打弯设备、分选机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等；

封装与测试配套：测试探针台、探针卡、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液、划片液、封片膜（胶）高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板、焊线控制、石英石墨、碳化硅等；

第三代半导体：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件（发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外）、电力电子器件（二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等）、微波射频器件（HEMT、MMIC）等；

半导体材料：硅片及硅基材料、硅晶圆、硅晶片、单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料、光刻胶及其配套试剂、晶圆胶带、光掩膜版、电子气体、特种化学气体、CMP抛光材料、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等；

AI+5G：人工智能、5G开发及应用、5G手机、5G通信（方案、设备、元器件、新材料、应用等）、智慧物联、物联网、智能安全、智慧城市、智能汽车、无人驾驶、智能传感、光电产业、智慧医疗、VR/AR、无线充电、屏下指纹、生物识别、工业互联网、智慧工厂、智能机器人、智能手机、智能交通、航空航天电子、智能家电、智能电视、智能家居、智能触控、智能穿戴、无人机、多接入边缘计算、网络切片、虚拟技术、医疗电子等；

Mini/Micro-LED：OLED显示屏、AMOLED显示屏、Micro-LED显示屏、Mini-LED显示屏片、驱动芯片、封装材料、蚀刻设备、剥离设备、检测设备、测试仪、光谱分析仪、测量设备、封装设备、巨量转移、喷涂设备；MovVD设备、液相外镀炉、返修台、光刻机、划片机、全自动固晶机、金丝球焊机、硅铝丝超声压焊机、灌胶机、真空烘箱、芯片计数仪、芯片检测仪、倒膜机、光色点全自动分选机等。

电子元器件：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件/IGBT、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继

电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品、无源器件、5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、储存器、连接器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇、电声器件、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等；

智慧电源：微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等；

综合：全国各地政府组团、半导体相关领域高科技产业园区、证券、银行、保险、基金、投资金融机构等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CHTF

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

知识科普：

半导体器件有许多封装型式，从DIP、SOP、QFP、PGA、BGA到CSP再到SIP，技术指标一代比一代先进，这些都是前人根据当时的组装技术和市场需求而研制的。总体说来，它大概有三次重大的革新：第1次是在上世纪80年代从引脚插入式封装到表面贴片封装，极大地提高了印刷电路板上的组装密度；第二次是在上世纪90年代球型矩正封装的出现，它不但满足了市场高引脚的需求，而且大大地改善了半导体器件的性能；晶片级封装、系统封装、芯片级封装是第三次革新的产物，其目的就是将封装减到小。每一种封装都有其独特的地方，即其优点和不足之处，而所用的封装材料，封装设备，封装技术根据其需要而有所不同。驱动半导体封装形式不断发展的动力是其价格和性能。